

INDEX

(English—日文—中文)

English	不良名	中文	コード	頁
---------	-----	----	-----	---

A

A displaced corner in crossed V grooves	交叉Vカット溝外はずれ	交叉 V 形槽の外側断离	6-2-9-	218
A foreign object under coverlay	カバーレイ下異物巻き込み	覆盖层的基底夹杂杂物	2-2-1-3	130
A metallic foreign object in solder resist	SR 金属異物巻き込み	SR 卷入金属屑	2-2-1-7	133
A non-metal foreign object trapped in solder resist	SR 非金属異物巻き込み	SR 卷入非金属杂物	2-2-1-5	132
A scratch on solder resist of FPC	FPCSR 等傷	FPC の SR 等划伤	2-1-2-11	114
Abnormal conductor pattern	異常形状回路	线路的形状异常	1-9-3-	99
Abnormal gold deposition	金めっき析出異常	镀金层的沉积异常	4-2-1-6	176
Abnormal thickness of plated copper	銅めっき厚異常	镀铜层厚度的异常	4-1-2-1	170
Abrasion mark on basis metal under solder resist	SR 下地研磨傷	SR 基底的磨伤	2-3-1-3	142
Abrasion mark on solder resist	SR 擦れ跡残り	SR 的摩擦痕迹	2-1-2-3	109
Adhered and projected conductor	導体貼付突起	导线转移的凸出	1-5-3-6	68
Adhered solder	はんだ付着	焊料的附着	4-3-2-5	190
Adhesive material on solder resist surface	SR 表面粘着物付着	SR 表面附着粘性物	2-2-1-15	137
Adjacent nicked conductors by foreign object	対面異形欠け	对面的异型缺口	1-2-1-3	35
Air entrapped in solder resist	SR 気泡抱込	SR 吸附气泡	2-1-1-8	104
An open tailing caused by a foreign object	異形裾残り断線	异型锯齿状的开路	1-1-1-8	6
Anomaly in direct copper plating	ダイレクト銅めっき異常	直接镀铜层的异常	4-1-1-5	169
Attached fibre on solder resist	SR 繊維付着	SR 附着纤维	2-2-1-2	129
Attached hair on solder resist	SR 人毛付着	SR 附着毛发	2-2-1-1	129
Attached solder on solder resist area	SR はんだ付着	SR 附着焊料	2-2-1-13	136

B

Bad machining	加工不良	加工不良	6-3-2-	222
Barrel crack of PTH wall	スルーホールバレルクラック	通孔的孔壁裂缝	8-1-2-4	264
Bleeding of undercoat at jumper terminal	ジャンパ端子アンダコートしみ	跨线插脚的底涂层渗油	7-4-15-	251
Blister	ブリスト	爆板	8-1-1-2	261
Blister, delamination, crack, lifting, etc.	膨れ・剥がれ・クラック・浮き等	分层、剥离、裂缝、鼓起	8-1-	260
Blistered gold deposit	金めっき膨れ	镀金层起泡	4-2-1-3	174
Blistered halogen-free base material	ハロゲンフリー材膨れ	无卤材料的分层	7-4-28-	257
Blistered solder resist	SR 膨れ	SR 分层	2-2-2-6	140

English	不良名	中文	コード	頁
Blurred silver paste	銀にじみ	银膏の渗出	5-2-6-	205
Blurred symbol mark	シンボルマークかすれ	字符不饱满	3-1-1-1	153
Board cracking by push back processs	プッシュバック加工割れ	回压の裂缝	6-1-4-	209
Board damage making a hole	穴傷	孔伤	7-4-22-	254
Board debris in solder resist	SR 基板加工屑卷込み	SR 卷入树脂屑	2-2-1-11	135
Bubble under FPC coverlay	FPC カバーレイ下気泡残り	FPC 覆盖层存在气泡	2-3-2-11	150
Bubble under FPC stiffener	FPC 補強板下気泡残り	FPC 增强板下吸附气泡	7-4-30-	258
Burned copper deposit	銅めっき焼け	镀铜层烧焦	4-1-2-3	171
Burr by punching	プレスバリ	冲切的披锋	6-1-9-	212
Burr by routing	ルータ加工バリ	铣切的披锋	6-4-12-	231
Burr in PTH	スルーホールバリ残り	通孔的披锋	5-1-1-2	193
Burr in V groove	V カット溝バリ	V 形槽的披锋	6-2-10-	219
Burr on FPC non-plated through hole by punching	FPC 非スル穴抜きバリ	FPC 非通孔的披锋	6-3-2-9	226

C

Caused by careless mistake	不注意(SR 欠陥)	疏忽(SR 的缺陷)	2-1-2-	108
Caused by careless mistake(Symbol mark defects)	不注意(シンボルマーク欠陥)	疏忽(字符的缺陷)	3-1-2-	156
Caused by damages to the board(Electrical open)	ダメージ起因(断線)	损坏起因(开路)	1-1-2-	10
Caused by defective basis metal	下地状態異常起因	基底的状态异常	4-2-3-	181
Caused by defective phototool(Conductor width reduction)	AWF 欠陥(細り)	AWVF 缺陷(细)	1-4-3-	55
Caused by foreign adhesive objects on plated surface (Electrical short)	めっき面付着粘性異物起因(短路)	镀层面附着粘性杂物的起因(短路)	1-8-2-	81
Caused by foreign object(electrical open)	異物起因(断線)	杂物起因(开路)	1-1-1-	1
Caused by foreign objects on the copper surface of laminate (Electrical short)	積層板銅箔面異物起因(短絡)	层压板铜箔面的杂物起因(短路)	1-8-1-	78
Caused by foreign objects(conductor protrusion)	異物起因(突起)	杂物起因(凸出)	1-5-1-	55
Caused by foreign objects(Copper plating defects)	異物起因(銅めっき欠陥)	杂物的起因(镀铜层的缺陷)	4-1-1-	167
Caused by foreign objects(expanded copper)	異物起因(太り)	杂物起因(线粗)	1-7-1-	75
Caused by foreign objects(gold plating defects)	異物起因(金めっき欠陥)	杂物起因(镀金层缺陷)	4-2-1-	173
Caused by foreign objects(nicks)	異物起因(欠け)	杂物起因(缺口)	1-2-1-	34
Caused by foreign objects(pinhole)	異物起因(ピンホール)	杂物起因(针孔)	1-3-1-	50
Caused by foreign objects(residual copper)	異物起因(残銅)	杂物起因(残余铜)	1-6-1-	70
Caused by foreign objects(solder resist defects)	異物起因(SR 欠陥)	杂物起因(SR 的缺陷)	2-2-	129
Caused by foreign objects(symbol mark defects)	異物起因(シンボルマーク欠陥)	杂物的起因(字符的缺陷)	3-2-1-	162
Caused by improper equipment(solder resist defects)	装置起因(SR 欠陥)	装置起因(SR 的缺陷)	2-3-1-	141
Caused by improper hole quality	穴内加工異常	孔加工异常	5-1-1-	193
Caused by improper plating condition(copper plating defects)	めっき条件管理不良起因(銅めっき欠陥)	电镀条件的管理不善(镀铜层的缺陷)	4-1-2-	170
Caused by improper plating condition(gold plating defects)	めっき条件管理不良起因(金めっき欠陥)	电镀条件的管理不善(镀金层缺陷)	4-2-2-	179
Caused by improper solder composition.	はんだ組成異常起因	焊料成分的异常	4-3-1-	185
Caused by incomplete etching	ET 残り突起	ET 残留的凸出	1-5-2-	64
Caused by irregular etching(Expanded copper)	ET 異常(太り)	ET 异常(线粗)	1-7-2-	76
Caused by over etch(Conductor width reduction)	ET 過多(細り)	ET 过度(细)	1-4-1-	53
Caused by photographic fogging	露光被り短絡	妨碍曝光的短路	1-8-3-	82

English	不良名	中文	コード	頁
Caused by poor dry film adhesion(Conductor width reduction)	DFR 密着不足（細り）	DFR 压合不紧（细）	1-4-2-	54
Caused by scratches(Electrical open)	基板傷起因（断線）	板件损伤的起因（开路）	1-1-3-	13
Caused by unskilled work(Solder resist defects)	技能未熟（SR 欠陥）	技能生疏（SR 的缺陷）	2-1-1-	100
Caused by unskilled work(Symbol mark defects)	技能未熟（シンボルマーク欠陥）	技能生疏（字符的缺陷）	3-1-1-	153
Ceiling dust on solder resist	SR 天井裏埃付着	SR 附着天棚里面的灰尘	2-2-1-4	131
Chipped board by punching	プレス欠け	冲切的缺口	6-1-8-	211
Chipped silver through hole overcoat	銀スルー用オーバコート欠け	银通孔的表面涂层有缺口	5-2-8-	206
Chipped symbol mark by a detached foreign object	シンボルマーク異物着脱欠け	字符上杂物脱落的缺口	3-2-1-3	163
Chipped symbol mark by screen clogging	シンボルマーク目詰欠け	字符网版的网目堵塞的缺口	3-1-2-10	161
Chipping by poor DFR adhesion on plugged hole Conductor nick on a plugged hole by poor dry film adhesion	穴埋凹み起因 DFR 不密着欠け	填孔凹陷，DFR 压合不紧的缺口。	1-2-2-14	49
Chipping by stained AWF Nick by stained phototool	AWF 汚れ欠け	AWF 玷污的缺口	1-2-2-6	44
Concave open	凹状断線	凹状的开路	1-1-1-6	4
Conductor defects	回路欠陥	线路缺陷	1-	1
Conductor nick and adjacent open by foreign object	断線同居異形欠け	与开路并存的异型缺口	1-2-1-2	35
Conductor pattern transferred on solder resist	SR 回路形状転写	SR 线路形状的转移	2-1-2-37	127
Conductor pattern-like short	パターン紛い短絡	疑似图形的短路	1-8-4-13	93
Conductor projection by adhered debris	压着表面突起	压着小铜屑的凸出	1-5-1-9	60
Conductor protrusion	突起	凸出	1-5-	55
Conductor width reduction	細り	线细	1-4-	53
Conductor-pattern-like open	回路状断線	线路形状的开路	1-1-1-4	3
Contact mark on iron-base printed board	鉄基板 SR 接触傷	铁基板的 SR 划伤	2-1-2-9	113
Contact mark on solder resist	SR 接触跡残り	SR 的接触痕迹	2-1-2-2	109
Convex open	凸状断線	凸状的开路	1-1-1-5	4
Convex tailing open	凸状裾残り断線	凸出锯齿状的开路	1-1-1-9	6
Copper deposit on paste	糊上銅めっき	胶迹上的镀铜层	4-1-1-2	168
Copper plating defects	銅めっき欠陥	镀铜层的缺陷	4-1-	167
Copper plating nodule	銅めっきノジュール	镀铜瘤	4-1-1-6	170
Copper plating void	銅めっきボイド	镀铜层的空洞	4-1-2-4	172
Copper PTH defects (excluding PTH open)	銅スルーホール欠陥（断線除く）	镀通孔的缺陷（开路除外）	5-1-	193
Copper transfer by electrostatic destruction	静電破壊転写	静电破坏的转移	7-4-20-	253
Corner crack of PTH	スルーホールコーナクラック	通孔的拐角有裂缝	8-1-2-2	263
Cracked board by punching	プレス基板割れ	板件的冲切裂缝	6-1-2-	208
Cracked edge board by punching	プレス基材端部クラック	基材边缘有冲切裂缝	6-1-11-	213
Cracked V-groove	Vカット溝割れ	V 形槽的断裂	6-2-7-	217
Cracking along perforation	プレスミシン目割れ	邮票孔的爆裂	6-1-6-	210
Cratered solder resist	SR はじき	SR 迸开变薄	2-2-1-14	136
Crazing	クレージング	微裂缝	8-1-1-4	262
Creased FPC edge contact	FPC 端子部折れ皺	FPC 插脚的折断起皱	7-4-26-	256
Cured ink debris on solder resist	SR インク屑付着	附着 SR 油墨屑	2-2-1-8	133
Cut on the basis conductor under solder resist by electrostatic discharge	SR 下地静電傷	SR 基底的静电损伤	2-3-2-8	149

English	不良名	中文	コード	頁
D				
Damaged PTH corner	スルーホールコーナダメージ	通孔拐角的损坏	5-1-2-10	202
Defective board fixing hole	取付け穴加工欠陥	安装孔的缺陷	6-4-14-	232
Defective counterbore	座繰り加工欠陥	沉孔的缺陷	6-4-1-	226
Defective hole shape	穴形状不良	孔的形状欠佳	6-3-2-8	225
Defective outlining	ルータ加工不良	铣切加工不良	6-4-9-	230
Defective resin flow in laminate	積層板樹脂流れ欠陥	层压板的树脂流动缺陷	7-3-3-	242
Defective resin flow in lamination	積層樹脂流れ不良	层压时树脂流动不畅	7-1-4-	236
Defective slot outlining	長穴ドリル加工不良	长孔的钻孔欠佳	6-3-2-7	225
Defective solder joints for component mounting	電子部品実装はんだ周り欠陥	元件封装焊料周围的缺陷	10-	270
Defective soldered PTH	スルーホールはんだ上がり欠陥	通孔的可焊性差	9-1-	267
Defects around PTH	スルーホール周りに発生する欠陥	通孔周围的缺陷	8-1-2-	263
Defects in machining slits, slots and perforations	スリット・長穴・ミシン目加工欠陥	槽口、长孔、邮票孔的缺陷	6-3-	220
Defects in soldering	はんだ上がり欠陥	可焊性的缺陷	9-	267
Defects of base material	基板に発生する欠陥	电路板上发生的缺陷	8-1-1-	260
Defects related to component mounting	実装に伴う欠陥	封装时的缺陷	10-1-	270
Deformed and broken open	変形切断断線	变形而切断的开路	1-1-2-1	10
Deformed conductor by board damage	回路線ダメージ変形	线路损坏的变形	1-9-1-	98
Deformed land	ランド変形	焊环变形	10-1-8-	275
Deformed slot by damaging	長穴ダメージ変形	长孔损坏的变形	6-4-11-	231
Deformed symbol mark	シンボルマーク崩れ	字符的崩溃	3-1-2-3	157
Delamination	積層板剥離	层压板的分层	7-3-4-	242
Delamination	デラミネーション	分层	8-1-1-1	260
Dent by automatic insertion	自挿痕	自动插入时的压痕	10-1-9-	276
Dent by test probe	チェッカ打痕	通断的压痕	7-4-2-	243
Dent in punching	プレス打痕	冲切的压痕	6-1-1-	208
Dent on coverlay	カバーレイ打痕	覆盖层的压痕	2-1-2-5	110
Dent on FPC base material surface	FPC ベース面打痕	FPC 基底有压痕	7-4-29-	258
Dent on gold plated edge board contact	金めっき端子打痕	镀金插脚的压痕	4-2-1-10	179
Dent on gold plated edge board contact	金端子部打痕	镀金插脚的压痕	7-4-12-	249
Dent on gold plating basis metal	金めっき下地打痕	镀金层的基底有压痕	4-2-3-1	181
Dent on laminate	積層打痕	层压板有压痕	7-1-3-	236
Dent on oblong hole edge	長穴エッジ打痕	长孔边缘有压痕	6-4-15-	233
Dent on solder resist	SR 打痕	SR 的压痕	2-1-2-4	110
Dent on solder resist on aluminum-base printed board	アルミ基板 SR 打痕	铝基板的 SR 压痕	2-1-2-6	111
Detached push back board	ブッシュバック加工外れ	回压的脱位	6-1-7-	211
Difficulty in breaking out at a V groove	Vカット溝割り困難	V 形槽的掰开困难	6-2-8-	217
Dirty bare-copper land	銅端子部汚れ	铜插脚的玷污	7-4-10-	248
Dirty base material under solder resist	SR 下地汚れ	SR 的基底玷污	2-1-2-26	121
Dirty board by pitch from cure oven	乾燥機ヤニ付着	附着松香	7-4-13-	250

English	不良名	中文	コード	頁
Dirty FPC surface	FPC 表面汚れ	FPC 表面の玷汚	2-1-2-25	121
Dirty symbol mark surface	シンボルマーク面汚れ	字符面的玷汚	3-2-1-4	163
Discoloured copper foil under coverlay	カバーレイ下地銅箔変色	覆盖层基底的铜箔变色	2-1-2-34	125
Discoloured gold deposit	金めっき変色	镀金层变色	4-2-1-2	174
Dish shaped nick	皿型厚み欠け	厚碟形的缺口	1-2-1-7	38
Dish shaped quasi open	皿型擬似断線	碟形的疑似开路	1-1-6-3	30
Displaced hole position	穴位置ズレ	孔位的偏移	6-4-2-	227
Displaced overcoat silver of through hole	銀スルオーバーコートズレ	银通孔的表面涂层的偏移	5-2-3-	203
Displaced symbol mark	シンボルマーク位置ズレ	字符的偏移	3-1-2-1	156
Displaced V groove position	Vカット溝位置ズレ	V 形槽的位置偏移	6-2-2-	214
Displacement in undercoat printing	アンダコート印刷ズレ	底涂层的印刷偏移	7-4-16-	251
Dissolved copper conductor by leaked electrolyte of capacitor	コンデンサ漏液による導体銅溶解	电容器漏液引起导线铜的溶解	7-4-21-	254
Drop of solder resist ink	SR 滴下付着	SR 的滴下并附着	2-1-2-16	116
Drop-in of hole plugging paste	穴埋インク垂込み	塞孔油墨的垂入	7-4-19-	253
Dry film debris on base material under solder resist	SR 下地 DFR 屑残り	SR 基底残留 DFR 屑	2-2-1-12	135
Dry film residue in an FPC hole	FPC 穴部 DFR 残り	FPC 孔残留 DFR	2-3-2-10	150
Dryfilm residue on conductor	導体部 DFR 残り	导线上有 DFR 屑	7-4-5-	245

E

Electrical open	断線	开路	1-1-	1
Electrical short	短絡	短路	1-8-	78
Entirely underdeveloped photo solder resist	全体的 P SR 現像残り	整个板面的 PSR 显影不净	2-1-1-9	104
Entrapped foreign object in solder	異物巻込はんだ	卷入杂物的焊料	4-3-2-1	188
Equipment contact mark on solder resist	SR 装置接触跡	SR 接触装置的痕迹	2-3-1-2	142
Etchback-shaped PTH sidewall	エッチバック形状スルーホール	凹蚀的通孔	5-1-2-4	198
Etched copper of base material	基板銅めっき面薬液食れ	镀铜面被药液腐蚀	1-2-2-10	47
Excessive number of V grooves	Vカット溝過多	V 形槽太多	6-2-6-	216
Excessive silver paste filling	銀充填過多	銀膏的充填过量	5-2-5-	204
Excessive silver paste thickness at hole neck	銀スル首部ペースト厚過剰	银通孔颈的银膏过剩	5-2-2-	203
Excessive solder mound	はんだ盛り上がり過多	焊料隆起太多	4-3-1-1	185
Expanded conductor by deteriorated etchant	ET 液劣化太り	ET 液变质的线粗	1-7-2-2	77
Expanded conductor by excessive etching-conveyor speed	ET 過速太り	ET 太快的线粗	1-7-2-1	76
Expanded conductor by photographic fogging	露光被り太り	曝光灰雾的线粗	1-7-1-1	75
Expanded conductor by photographic thermal fogging	熱被り太り	散热差的线粗	1-7-3-2	78
Expanded copper	太り	线粗	1-7-	75
Exposed conductive paste	導電ペースト露出	导电膏的露出	7-4-14-	250
Exposed copper by V-grooving	Vカットによる銅見え	V 形槽露銅	6-2-11-	219
Exposed copper in peeled symbol mark print	シンボルマーク印刷部銅見え	在字符部位露銅	3-2-1-5	164
Extra hole	余分穴	多余孔	6-3-2-6	224

English	不良名	中文	コード	頁
F				
Fall-off of cantilever outside of V groove	Vカット溝外方持部脱落	V 形槽的单側脱落	6-2-12-	220
Fine scratch on solder resist on iron-base printed board	鉄基板 SR 傷表面微細傷	铁基板的 SR 表面的微裂痕	2-3-2-3	146
Fingerprint on base material under solder resist	SR 下地指紋汚れ	SR 基底의指纹玷污	2-1-2-28	122
Fingerprint on solder resist surface	SR 指紋汚れ転写	SR 指纹玷污的转移	2-1-2-19	118
Fingerprint on the solder resist surface	SR 表面指紋残り	SR 表面印有指纹	2-1-2-35	126
Foil crack in PTH	スルーホールフォイルクラック	通孔箔裂缝	8-1-2-3	264
Foreign object between layers	積層層間異物巻き込み	层压板的层间卷入杂物	7-1-5-	247
Foreign object entrapped in silver paste	銀ペースト異物巻き込み	银膏卷入杂物	5-2-7-	205
Foreign object in carbon paste print	カーボン印刷異物巻き込み	碳油卷入杂物	7-4-1-	243
Foreign object in laminate	積層板中異物巻き込み	层压板中卷入杂物	7-3-1-	240
Foreign object on conductive paste jumper	導電ペーストジャンパ異物付着	导电膏跨线附着杂物	7-4-17-	252
Foreign object on divided PTH terminal	スルーホール割り端子異物付着	半孔插脚附着杂物	7-4-9-	248
Foreign object on gold edge board contact	金めっき端子異物付着	镀金插脚上附着杂物	4-2-1-9	178
Foreign object on preflux (OSP)	プリフラックス (OSP) 異物付着	预助焊剂 (OSP) 附着杂物	7-2-3-	239
Foreign object remained (solder resist defects)	異物残存 (SR 欠陥)	杂物残留 (SR 的缺陷)	2-2-1-	129
Foreign objects on FPC surface	FPC 表面異物付着	FPC 表面附着杂物	2-1-2-24	120
FPC stiffener displacement	FPC 補強板ズレ	FPC 增强板的偏移	7-4-24-	255
FPC stiffener separation	FPC 補強板剥がれ	FPC 增强板的剥落	7-4-25-	256
G				
Glass fiber protrusion in PTH	スルーホール内ガラス基材凸出	通孔内的玻璃纤维凸出	5-1-1-3	194
Gold deposit on unnecessary area	ムダ金めっき付着	多余的镀金层	4-2-4-2	185
Gold particle scattered on solder resist	金めっき降り	镀金层的下沉	4-2-2-1	179
Gold plating defects	金めっき欠陥	镀金层缺陷	4-2-	173
Gold plating pit on corroded Ni basis	下地 Ni 腐食金めっきビット	基底镍层被腐蚀引起镀金层的凹坑	4-2-3-6	184
Granular nodule on gold plated surface	金めっき表面粒状突起	镀金表面的粒子凸出	1-5-3-8	69
Groove-shaped open	溝形断線	槽型的开路	1-1-1-11	8
H				
Hair crack in nickel/gold deposit	ニッケル金めっきヘアクラック	镀镍金层的龟裂	6-1-3-	209
Hair-cracked board	基板ヘアクラック	板边的龟裂	6-4-16-	233
Haloing	ハローイング	晕圈	6-1-10-	212
Haloing by routing	ルータ加工ハローイング	铣切的晕圈	6-4-10-	231
Hole break-out by misalignment	合せズレランド欠け	错位的焊环缺口	1-2-2-7	45
Hole fragment	スルーホールランド欠け	焊环的缺口	5-1-2-6	200
Hole plugged with punch debris	プレス滓上がり	冲切渣的堵塞	7-4-8-	247
Hole with burrs	穴バリ	孔的披锋	6-4-6-	229
Human-originated foreign object	人体系異物付着	附着人体的污垢	2-2-1-9	134

English	不良名	中文	コード	頁
I				
Improper gold deposit thickness	金めっき厚不良	镀金层的厚度不足	4-2-2-2	180
Improper printing work(Symbol mark defects)	印刷作業不適 (シンボルマーク欠陥)	印刷作业不熟练(字符的缺陷)	3-1-	153
Improper residual laminate thickness in V-grooving (Improper throat thickness)	Vカット溝のど厚不良	V形槽的厚度不足	6-2-3-	215
Improper V groove angle	Vカット溝角度不良	V形槽的角度不良	6-2-4-	215
Improper work(Solder resist defects)	作業不適(SR欠陥)	作业不熟练(SR的缺陷)	2-1-	100
Inaccurate coverlay placement	カバーレイ貼りズレ	覆盖膜的压合偏移	2-1-1-3	101
Ink drop and run on solder resist surface	SR滴下引ずり付着	滴下SR并拖拉	2-1-2-18	117
Ink-stained conductor under solder resist	SR基底地インク汚れ	SR基底的油墨玷污	2-1-2-40	128
Insufficient board reliability	信頼性不足	可靠性差	8-	260
Insufficient dielectric strength	耐電圧不足	介质强度差	8-2-1-	265
Insufficient silver paste filling	銀スル充填不足	银通孔的填充不足	5-2-1-	202
Insufficient solder filling in PTH	はんだ充填不足	焊料填充不足	9-1-1-	267
Insufficient solder resist thickness at a conductor edge	SRエッジ厚不足	SR边缘厚度不足	2-3-2-2	146
Insufficient throwing power	スローイングパワ不適	分散能力差	4-1-2-5	172
Insufficient underfill under conductive paste jumper	導電ペーストジャンパ下充填不足	导电膏的基底填充不足	7-4-18-	252
Internal layer open	内層断線	内层的开路	1-1-1-14	9
Isolated nick by foreign object	单独異形欠け	异型的单独缺口	1-2-1-1	34
L				
Laminate defects	積層板欠陥	层压板的缺陷	7-3-	240
Lamination defects	積層欠陥	层压的缺陷	7-1-	235
Layer-to-layer misalignment	層間ズレ	层间偏移	7-1-1-	235
Layer-to-layer short by a conductive foreign object	層間導電異物短絡	导电性杂物的层间短路	1-8-4-11	92
Leaned hole	穴曲がり	孔的弯曲	6-4-3-	227
Lifted land	ランド剥離	焊环的剥离	10-1-2-	271
Lifted land of PTH	スルーホールランドリフト浮き	焊环的翘起	8-1-2-1	263
Lift-off	リフトオフ	剥离	10-1-1-	270
Local uneven colour of solder resistcolour	部分的SR色むら	SR的颜色局部不均匀	2-1-1-15	107
Locally reduced width of conductor	部分的細り	局部的线细	1-4-1-2	53
M				
Machining defects	機械加工欠陥	机械加工的缺陷	6-	208
Machining process omitted	加工漏れ	漏加工	6-3-1-	220
Marker pen mark on base material under solder resist	SR下地マジックマーク残り	SR基底残留墨水标记	2-1-2-31	124
Marks of foreign object(solder resist defects)	異物非残存(SR欠陥)	非杂物残留(SR的缺陷)	2-2-2-	137
Measling	ミーズリング	白斑	8-1-1-3	261
Migration along glass cloth surface (CAF = Conductive Anodic Filament)	ガラスクロスマイグレーション (CAF)	在玻璃纤维的迁移	1-8-4-7	89
Migration along void	空隙マイグレーション	在空隙的迁移	1-8-4-8	90
Migration at interface	界面マイグレーション	界面的迁移	1-8-4-6	89

English	不良名	中文	コード	頁
Migration within resin	樹脂中マイグレーション	在树脂中的迁移	1-8-4-5	88
Misalignment in punching	プレス抜きズレ	冲切的偏移	6-1-5-	210
Missing Hole wall conductor of PTH	スルーホール欠け	通孔的缺口	5-1-2-7	200
Missing silver-paste through hole	銀スルーホール欠落	银通孔的欠缺	5-2-9-	206
Multiple opens caused by a foreign object	複数異形断線	多条的异型开路	1-1-1-2	2
Multiple shrinkage cavities	複数引け巣	多点的收缩孔	10-1-4-	273
Multiple tailed open	複数裾残り断線	多条锯齿状的开路	1-1-1-12	8

N

Nail head	ネイルヘッド	钉头	5-1-1-1	193
Narrow spacing between edge board contacts	端子部導体間隔小	插脚的导线间距小	1-7-3-1	77
Needle-shaped open	針状断線	針状的开路	1-1-1-7	5
Negative-etchback-shaped PTH side wall	逆エッチバック形状スルーホール	反向凹蚀的通孔	5-1-2-5	199
Nick by adhesive sandwiching	サンドイッチ欠け	夹层的缺口	1-2-1-8	39
Nick by base material dent	基板打痕欠け	板件压痕的缺口	1-2-2-4	43
Nick by board damage	ダメージ欠け	损伤的缺口	1-2-2-5	44
Nick by board surface damage	基板傷欠け	板伤的缺口	1-2-2-1	42
Nick by dent	打痕欠け	压痕的缺口	1-2-1-12	41
Nick by dent on base material	基材打痕欠け	基材压痕的缺口	1-2-1-9	39
Nick by electrostatic discharge	静電気傷欠け	静电损伤的缺口	1-2-2-3	43
Nick by hair	毛髪起因欠け	毛发的缺口	1-2-1-11	40
Nick by poor dry film adhesion	DFR 密着不良欠け	DFR 压合不紧的缺口	1-2-2-2	42
Nick by residual adhesive	糊残り欠け	胶迹的缺口	1-2-1-6	37
Nick by tear and transfer of conductor	導体貼付欠け	导线转移的缺口	1-2-2-12	48
Nick by tearing around large hole	大径穴周り引掛け欠け	大径孔周围拉裂的缺口	1-2-2-11	47
Nick of carbon printed pattern	カーボン印刷欠け	碳油印刷的缺口	1-2-2-13	48
Nick of edge edge contact by a foreign object	異物起因端子欠け	插脚的杂物缺口	1-2-1-10	40
Nick of fiducial mark	基準マーク欠け	基准标记的缺口	1-2-2-9	46
Nick of Inner layer conductor	内層欠け	内层的缺口	1-2-1-13	41
Nick on solder resist	SR 当て傷	SR 的碰伤	2-1-2-13	115
Nicks	欠け	缺口	1-2-	34
No gold deposit	金めっき不付	金层不粘结	4-2-1-1	173
No solder on terminal	端子部はんだ不付き	插脚的焊料不粘结	4-3-2-8	191
No solder resist on conductor defect	回路欠陥部 SR 不付	SR 在线路缺陷部位不黏结	2-3-2-6	148
Nodule on PTH wall	スルーホール内壁ノジュール	通孔内壁的镀瘤	5-1-2-3	198

O

Omitted perforation process	ミシン目加工漏れ	漏开邮票孔	6-3-1-3	221
Omitted slitting process	スリット加工漏れ	漏开槽口	6-3-1-1	220
Omitted slotting process	長穴加工漏れ	漏开长孔	6-3-1-2	221
Open along scratch	傷断線	划伤的开路	1-1-2-3	11

English	不良名	中文	コード	頁
Open by etched down blind via	ブラビア食われ断線	盲孔被腐蚀的开路	1-1-4-12	24
Open by a dislocated V groove	V カット溝かぶり断線	V 形槽错位的开路	1-1-5-2	26
Open by abrasion scratch	研磨傷断線	磨伤的开路	1-1-3-2	13
Open by absence of blind via hole	ブラビア形成漏れ断線	漏钻盲孔的开路	1-1-4-11	24
Open by damaged base material	基材ダメージ部食われ断線	基材损坏并被腐蚀的开路	1-1-3-6	16
Open by damaged surface of internal base material	内層材表面傷起因断線	内层表面划伤的开路	1-1-2-5	12
Open by defective plating by an attached foreign object	異物付着めっき不良断線	镀层附着杂物的开路	1-1-1-13	9
Open by electrostatic discharge	静電傷断線	静电伤的开路	1-1-3-4	14
Open by flexural fatigue of FPC	FPC 屈曲疲労断線	FPC 弯曲疲劳的开路	1-1-5-5	28
Open by handling scratch	取扱傷断線	操作上损伤的开路	1-1-3-3	14
Open by impact cracking	衝撃割れ断線	冲击裂缝的开路	1-1-2-2	11
Open by impact scrape	衝撃削れ断線	冲击切削的开路	1-1-2-4	12
Open by improper hole on conductor	穴かぶり断線	孔错位的开路	1-1-5-1	26
Open by non-plated blind via	ブラビアめっき不析出断線	盲孔无镀层的开路	1-1-4-13	25
Open by poor dry film adhesion	DFR 密着不良断線	DFR 压合不紧的开路	1-1-5-4	28
Open by torn-off and sticked conductor	導体貼付断線	导线转移的开路	1-1-5-3	27
Open caused by residual adhesive	糊残り断線	胶迹的开路	1-1-1-10	7
Open caused by scratch on board	基板傷断線	板伤的开路	1-1-3-1	13
Open PTH by broken tenting	テント破れスル断	掩膜破裂的通孔开路	1-1-4-1	16
Opens by multiple scratches	複数傷断線	多处损伤的开路	1-1-3-5	15
Other defects	その他欠陥	其它的缺陷	7-	235
Other solder resist related defects	その他 (SR その他欠陥)	其它 (SR 及其它的缺陷)	2-3-2-	145
Others	その他	其它	8-2-	265
Others(conductor defects)	その他 (回路欠陥)	其它 (线路缺陷)	1-9-	98
Others(conductor protrusion)	その他 (突起)	其它 (凸出)	1-5-3-	65
Others(copper PTH defects (excluding PTH open))	その他 (銅スルーホール欠陥 (断線除く))	其它 (镀通孔的缺陷 (开路除外))	5-1-2-	196
Others(Electrical open)	その他 (断線)	其它 (开路)	1-1-5-	26
Others(Expanded copper)	その他 (太り)	其它 (线粗)	1-7-3-	77
Others(gold plating defects)	その他 (金めっき欠陥)	其它 (镀金层缺陷)	4-2-4-	184
Others(machining defects)	その他 (機械加工欠陥)	其它 (机械加工的缺陷)	6-4-	226
Others(other defects)	その他 (その他欠陥)	其它 (其它的缺陷)	7-4-	243
Others(pinhole)	その他 (ピンホール)	其它 (针孔)	1-3-2-	51
Others(residual copper)	その他 (残銅)	其它 (残余铜)	1-6-2-	74
Others(Electrical short)	その他 (短絡)	其它 (短路)	1-8-4-	86
Others(solder coating (HAL) defects)	その他 (はんだコーティング (HAL) 欠陥)	其它 (热风整平 (HAL) 的缺陷)	4-3-2-	188
Others(solder resist defects)	その他 (SR 欠陥)	其它 (SR 的缺陷)	2-3-	141
Others(symbol mark defects)	その他 (シンボルマーク欠陥)	其它 (字符的缺陷)	3-2-	162
Others(symbol mark defects)	その他 (シンボルマーク欠陥)	其它 (字符的缺陷)	3-2-2-	164
Outward conductor projection by adhered debris	圧着突起	压着铜屑的凸出	1-5-1-8	60
Overcured solder resist	SR 過焼き	SR 的烘干过度	2-1-2-36	126
Overcured symbol mark	シンボルマーク過焼	字符的烘干过度	3-1-2-9	161

English	不良名	中文	コード	頁
P				
Partially underdeveloped photo solder resist	部分的 P SR 現像残り	局部的 PSR 显影不净	2-1-1-10	105
Partially uneven solder resist	SR 部分的むら	SR 的局部颜色不均匀	2-3-1-7	144
Partly unprinted symbol mark	シンボルマーク部不印刷	字符的漏印	3-1-2-8	160
Paste on counterbored area	座繰り部糊付着	沉孔的胶迹	7-4-11-	249
Pasty foreign material under solder resist	SR 下地糊状異物付着	SR の基底附着粘性杂物	2-1-2-27	122
Pasty foreign object on solder resist surface	SR 表面糊状異物付着	SR 表面附着粘性杂物	2-1-2-21	119
Peeled gold deposit	金めっき剥がれ	镀金层的剥落	4-2-1-4	175
Peeled off solder resist by impact	SR 衝突剥がれ	SR 碰撞的剥落	2-1-2-8	112
Peeled off solder resist on iron-base printed board	鉄基板 SR 付着物剥がれ	铁基板附着 SR 并剥落	2-1-2-7	112
Peeled paint debris in solder resist	SR 剥離塗装片卷込み	SR 卷入油漆屑	2-2-1-10	134
Peeled solder resist along locally plated gold deposited boundary	部分金めっき境界部 SR 剥れ	在部分镀金层的边界 PSR 剥落	2-3-2-5	147
Peeled solder resist by tacking	SR タッキング剥がれ	SR 钉头状的剥落	2-3-1-1	141
Peeled symbol mark	シンボルマーク剥がれ	字符的剥落	3-1-1-3	154
Peeled symbol mark	シンボルマーク剥がれ	字符的剥落	3-2-1-1	162
Photo solder resist missing caused by a foreign object	PSR 未露光部不付き	PSR 未曝光部位的剥落	2-2-2-3	138
Photo solder resist residue after electrostatic coating	静電コート塗布 P SR 現像残	静电喷涂的 SR 显影残渣	2-3-2-9	149
Phototool misalignment	AWF 合せズレ	AWF 对位的偏移	2-1-1-2	101
Pinch mark on solder resist	SR 挟まれ傷	SR 的夹伤	2-3-1-4	143
Pinhole	ピンホール	针孔	1-3-	50
Pinhole	ピンホール	针孔	1-3-1-1	50
Pinhole by electrostatic discharge	静電気ピンホール	静电划伤的针孔	1-3-2-1	51
Pinhole by stained phototool	AWF 汚れピンホール	AWF 玷污的针孔	1-3-2-2	51
Pinhole by tear and transfer of conductor	導体貼付ピンホール	导线转移的针孔	1-3-2-3	52
Pinhole in gold deposit	金めっきピンホール	镀金层的针孔	4-2-1-5	175
Pinhole in symbol mark	シンボルマークピンホール	字符有针孔	3-1-1-5	155
Pit	ピット	麻点	1-3-1-2	50
Pit on gold deposit caused by base copper defect	下地銅欠陥金めっきピット	基底铜层有缺陷引起镀金层的凹坑	4-2-3-4	183
Pit on gold deposit caused by base nickel defect	下地 Ni 欠陥金めっきピット	基底镍层有缺陷引起镀金层的凹坑	4-2-3-5	183
Pit on gold deposit caused by degraded base copper	下地銅変質起因金めっきピット	基底铜层变质引起的镀金层凹坑	4-2-3-3	182
Pit on gold deposit caused by laminate defect	積層板欠陥起因金めっきピット	层压板的缺陷引起镀金层的凹坑	4-2-3-2	182
Plated copper blistering	銅めっき膨れ	镀铜层起泡	4-1-1-3	168
Plating defects	めっき欠陥	电镀的缺陷	4-	167
Plating nodule	めっきノジュール	镀瘤	1-5-1-11	62
Plating void in PTH	スルーホールボイド	通孔的空洞	5-1-2-2	197
Poor peel strength of plated copper	銅めっき剥がれ	镀铜层的剥落	4-1-2-2	171
Poor solder luster	はんだ光沢不良	焊料无光泽	4-3-1-2	186
Poor solder wetting by foreign material	異物起因はんだ濡れ不良	杂物起因的不润湿	4-3-2-7	191
Poor solder wetting by improper solder composition	組成異常はんだ濡れ不良	成分异常, 润湿性差	4-3-1-3	186
Preflux (OSP) application defects	ブリフラックス欠陥	预助焊剂的缺陷	7-2-	238

English	不良名	中文	コード	頁
Projected conductive paste jumper	導電ペーストジャンパ突起	导电膏跨线的凸出	1-5-3-5	68
Projected conductor by a defective phototool	AWF 傷突起	AWVF 划伤的凸出	1-5-1-1	55
Projected conductor by adhesive on CCL surface	積層板表面糊付着突起	层压板面有胶迹的凸出	1-5-1-5	58
Projected conductor by adhesive on plated surface	めっき面糊付着突起	镀层面有胶迹的凸出	1-5-1-6	59
Projected conductor by adhesives	粘着物付着突起	粘性物的凸出	1-5-1-14	62
Projected conductor by damaged board	ダメージ突起	压伤的凸出	1-5-3-1	65
Projected conductor by debris of carrier film adhesive	CF 接着剤残り突起	CF 粘着剂屑的凸出	1-5-1-13	62
Projected conductor by etching nozzle clogging	ET ノズル詰り突起	ET 喷嘴堵塞的凸出	1-5-2-2	65
Projected conductor by etching of conductor	腐食突起	腐蚀的凸出	1-5-3-2	66
Projected conductor by exposing light leakage	露光被り突起	曝光阴影的凸出	1-5-1-2	56
Projected conductor by improper pattern configuration	回路形状不適突起	线路形状异常的凸出	1-5-2-1	64
Projected conductor by prepreg debris	プリプレグ残り突起	B 片屑的凸出	1-5-1-7	59
Projected conductor by scam	スカム突起	余膜的凸出	1-5-1-3	56
Projected conductor by sludge	ヘドロ突起	粘性污泥的凸出	1-5-1-4	57
Projected conductor by through-hole burr	スルーホールバリ突起	通孔披锋的凸出	1-5-3-7	69
Projected conductor from laser drilled hole	レーザ穴突起	激光孔的凸出	1-5-3-4	67
PTH defects	スルホール欠陥	通孔的缺陷	5-	193
PTH hole clogging with foreign object	スルーホール内異物詰まり	通孔内堵塞杂物	5-1-2-1	196
PTH open by circumferential resin smear	スル周リスマ残りスル断	孔壁周围残留钻污的通孔开路	1-1-4-10	23
PTH open by delamination	層間剥離スル断	爆板的通孔开路	1-1-4-5	20
PTH open by etching of conductor by residual chemical	残液食われスル断	残液腐蚀的通孔开路	1-1-4-2	17
PTH open by land break	ランド欠けスル断	焊环缺损的通孔开路	1-1-4-6	20
PTH open by mechanical shock	衝撃クラックスル断	冲击裂缝的通孔开路	1-1-4-3	18
PTH open by plugging of a foreign object	異物詰りスル断	堵塞杂物的通孔开路	1-1-4-8	22
PTH open by resin smear on via bottom land	スル下スマ残りスル断	钻污的通孔开路	1-1-4-9	23
PTH open by trapped bubble	気泡残りスル断	残留气泡的通孔开路	1-1-4-4	19
PTH open by trapped bubble in rugged hole	穴荒れによる気泡残りスル断	孔粗糙吸附气泡的通孔开路	1-1-4-7	21
PTH opens	スルホール断線	通孔的开路	1-1-4-	16
Punching defect	プレス加工欠陥	冲切的缺陷	6-1-	208

Q

Quasi open	疑似断線	疑似开路	1-1-6-	29
Quasi open by abrasion scratch	研磨傷起因疑似断線	磨伤的疑似开路	1-1-6-7	33
Quasi open by dissolution	はんだ溶食疑似断線	焊料溶蚀的疑似开路	1-1-6-2	29
Quasi open by electrostatic discharge	静電傷疑似断線	静电损伤的疑似开路	1-1-6-5	31
Quasi open by nicking	欠け状疑似断線	疑似缺口的开路	1-1-6-1	29
Quasi open by sandwiched adhesive	糊サンド疑似断線	夹心胶的疑似开路	1-1-6-4	31
Quasi PTH open	スルーホール疑似断線	通孔的疑似开路	1-1-6-6	32
Quasi short	疑似短絡	疑似短路	1-8-4-15	95
Quasi short by copper debris between conductor	銅片挟まり短絡	夹杂铜片的疑似短路	1-8-4-16	95
Quasi short by misaligned via hole	ビアホールズレ疑似短絡	导通孔偏移的疑似短路	1-8-4-18	96

English	不良名	中文	コード	頁
R				
Raised copper deposit at PTH hole edge	銅スルコーナ盛上り	通孔拐角の鼓起	5-1-2-8	201
Reduced conductor width by a defective phototool	AWF 欠陥細り	AWF 缺陷的线细	1-4-3-1	55
Reduced conductor width by poor dry film adhesion	DFR 密着不足細り	DFR 压合不紧的线细	1-4-2-1	54
Reduced width throughout the conductor width	全体的細り	整体的线细	1-4-1-1	53
Repelled preflux (OSP)	ブリフラックス (OSP) はじき	预助焊剂的凹陷	7-2-5-	240
Residual copper	残銅	残余铜	1-6-	70
Residual copper by a foreign object in laminate	積層板巻込異物による残銅	层压板卷入残余铜	1-6-1-6	73
Residual copper by carrier-film adhesive residue	CF 接着剤残り残銅	CF 粘性物的残余铜	1-6-1-4	72
Residual copper by clogged etching nozzle	ET ノズル詰り残銅	ET 喷嘴堵塞的残余铜	1-6-2-1	74
Residual copper in laminate	積層板樹脂中残銅	层压板树脂中的残余铜	1-6-1-5	72
Residual copper on board border area	捨て基板部残銅	板边的残余铜	1-6-2-2	75
Residual copper under paste adhered on laminated copper foil	積層銅箔面糊付着残銅	铜箔表面胶迹的残余铜	1-6-1-3	71
Residual copper under prepreg debris	プリプレグ残銅	B 片屑的残余铜	1-6-1-2	70
Resin recession of PTH wall	スルーホールレジンリセッション	通孔的树脂凹缩	8-1-2-5	265
Resin smear in PTH	スルーホール内スミア残り	通孔内残留钻污	5-1-1-5	196
Resulted from other causes(nicks)	その他起因(欠け)	其它起因(缺口)	1-2-2-	42
Reversely printed symbol mark	シンボルマーク逆刷り	字符的反向印刷	3-1-2-4	158
Rough copper electrodeposit	銅めっきザラ	镀铜层粗糙	4-1-1-1	167
Rough edged conductor	回路ギザ	锯齿的线路	1-2-2-8	45
Rough hole wall	スルーホール内壁荒れ	通孔内壁粗糙	5-1-1-4	195
Rough plating	めっきザラ	碟形镀层	1-5-1-10	61
Round nick by dent	円形打痕欠け	圆形压痕的缺口	1-2-1-5	37
Rubbed symbol mark	シンボルマークこすれ	字符被磨擦	3-1-2-2	157
Rugged hole by drill bit deflection	ドリル振れ穴荒れ	钻嘴摆动的孔粗糙	6-4-5-	228
S				
Scraped solder resist on iron-base printed board	鉄基板 SR 傷	铁基板的 SR 划伤	2-3-1-8	145
Scratch made in HAL	レベラ傷	热风整平时划伤	4-3-2-3	189
Scratch on base laminate under solder resist	SR 下地基板樹脂部傷	SR 基材的树脂损伤	2-1-2-33	125
Scratch on coverlay	カバーレイ傷	覆盖层的划伤	2-1-2-12	114
Scratch on gold deposit	金めっき傷	镀金层的划伤	4-2-1-7	176
Scratch on solder resist	SR 接触傷	SR 的划伤	2-1-2-10	113
Scratch on solder resist by board pulling	SR 引拔擦り傷	SR 的拉伤	2-1-2-14	115
Scratch on solder resist by HAL	SR レベラ傷	SR 在热风整平时的划伤	2-3-1-5	143
Scratch on solder resist of iron-base board by board pulling	鉄基板 SR 引拔擦り傷	铁基板的 SR 拉伤	2-1-2-15	116
Scratch on solder resist of the equipment	SR 装置傷	SR 接触装置的伤痕	2-3-1-6	144
Scratch on the conductor under solder resist	SR 下地導体傷	SR 基材的导线损伤	2-1-2-32	124
Scum or sludge-like residual copper	スカム・ヘドロ残銅	余膜、污泥的残余铜	1-6-1-1	70
Separated perforation	ミシン目割れ	邮票孔的裂开	6-4-13-	232

English	不良名	中文	コード	頁
Separation of solder from component lead	リード線界面剥離	引脚的界面剥离	10-1-5-	273
Separation of solder from PTH wall	はんだスルーホール内壁剥離	通孔内壁的焊料剥离	10-1-7-	274
Separation of through-hole plating	スルーホールめっき剥離	通孔镀层剥离	10-1-6-	274
Sharp bend of FPC	FPC 折れ	FPC 的折断	7-4-27-	257
Short between carbon paste conductors	カーボン回路短絡	碳膏线路的短路	1-8-4-17	96
Short by a conductive foreign object within solder resist	導電性異物 SR 巻込短絡	SR 中卷入导电性杂物的短路	1-8-4-2	86
Short by a foreign object under a phototool	AWF 下異物短絡	AWF 下面杂物的短路	1-8-3-1	82
Short by adhered adhesive	糊付着短絡	胶迹的短路	1-8-2-3	82
Short by adhesive foreign material	粘性異物短絡	粘性杂物的短路	1-8-1-1	78
Short by an adhered conductive foreign object	導電性異物圧着短絡	压入导电性杂物的短路	1-8-4-1	86
Short by bubble under phototool	AWF 下気泡短絡	AWF 下面存在气泡的短路	1-8-3-2	83
Short by carrier film adhesive	CF 接着剤短絡	CF 粘性物的短路	1-8-1-3	79
Short by clogged etching nozzle	ET ノズル詰り短絡	ET 喷嘴堵塞的短路	1-8-4-9	91
Short by damaged conductor	ダメージ短絡	损伤的短路	1-8-4-3	87
Short by dry film scum	DFR スカム短絡	DFR 余膜的短路	1-8-2-1	81
Short by improper conductive pattern	回路形状不適短絡	线路设计不合理的短路	1-8-4-19	97
Short by misaligned via hole	ビアホールズレ短絡	导通孔偏移的短路	1-8-4-14	94
Short by narrowed conductor spacing	導体間隔狭まり短絡	导线间距变窄的短路	1-8-4-12	93
Short by photographic fogging by an adhered fibrous object	繊維状異物介在露光被り短絡	纤维杂物妨碍曝光的短路	1-8-3-6	85
Short by photographic fogging on rough plating	めっき面凹凸露光被り短絡	镀层面凹凸妨碍曝光的短路	1-8-3-3	83
Short by poor phototool contact	AWF 密着不良短絡	AWF 压合不紧的短路	1-8-3-4	84
Short by prepreg debris	プリプレグ短絡	B 片屑的短路	1-8-1-4	80
Short by scratch on phototool	AWF 傷短絡	AWF 划伤的短路	1-8-3-5	84
Short by sludge	ヘドロ短絡	粘性污泥的短路	1-8-2-2	81
Short by solder bridge	はんだブリッジ短絡	焊料桥接的短路	1-8-4-10	92
Short by tape adhesive	テープ糊短絡	胶带胶迹的短路	1-8-1-2	79
Short by wicking	ウィッキング短絡	灯芯的短路	1-8-4-4	87
Shrinkage cavity	引け巣	收缩孔	10-1-3-	272
Silver-paste through-hole defects	銀スルーホール欠陥	银通孔的缺陷	5-2-	202
Single open by a foreign object	単独異形断線	单独的异型开路	1-1-1-1	1
Sliver	スリバ	镀屑	1-5-3-3	66
Small insect body on solder resist	SR 微細虫死骸付着	SR 附着幼虫尸骸	2-2-1-6	132
Soil by symbol mark ink	シルクインク付着	丝印油墨的附着	3-2-1-2	162
Soil of symbol mark ink	シンボルマークインク付着	附着字符油墨	3-1-2-7	159
Soils rubbed on solder resist surface	SR 擦り付け付着	擦上并附着 SR	2-1-2-17	117
Solder ball adhesion	はんだボール付着	焊珠的附着	4-3-2-6	190
Solder bridge by improper solder composition	組成異常はんだブリッジ	成分异常的桥接	4-3-1-4	187
Solder coating (HAL) defects	はんだコーティング (HAL) 欠陥	热风整平 (HAL) 的缺陷	4-3-	185
Solder joint defects after thermal shock testing of about 1000 heat cycles	熱衝撃 (1000c) 前後の実装欠陥	热冲击 (1000c) 前后的封装焊接缺陷	10-2-1-	279
Solder joint defects before and after thermal shock test	熱衝撃試験前後の実装はんだ周り欠陥	热冲击试验前后的封装焊接周围的缺陷。	10-2-	279
Solder joint defects by use of solder of different makes	はんだ差による実装欠陥	封装的缺陷因焊料而差别	10-1-11-	277

English	不良名	中文	コード	頁
Solder joint defects due to different products used	積層板差による実装欠陥	封装的缺陷因层压板而差别	10-1-10-	277
Solder joint with blow hole	ブローホールはんだ	焊料有气孔	9-1-4-	268
Solder only on through-hole bottom	底張りはんだ	不润湿	9-1-2-	267
Solder only on through-hole land	ランド舐めはんだ	焊环的吸锡	9-1-3-	268
Solder plugged hole	穴内はんだ詰り	孔内堵塞焊料	4-3-2-2	188
Solder resist (spread) ooze	SR にじみ	SR 的渗出	2-1-1-5	102
Solder resist blur	SR かすれ	SR 的漏印	2-1-1-4	102
Solder resist blur by ink run-out	SR インク切れかすれ	SR 油墨中断的漏印	2-1-2-1	108
Solder resist crack	SR 割れ	SR 的裂缝	2-1-1-16	108
Solder resist cracking in a narrow area	SR 狭陰部割れ	SR 在狭陰部位的裂痕	2-3-2-12	151
Solder resist debris from between terminals entrapped in solder	端子間 SR 剥離片はんだ巻き込み	焊料卷入插脚之间的 SR 碎片	4-3-2-10	192
Solder resist defects	SR 欠陥	SR 的缺陷	2-	100
Solder resist dripped in non-plated through hole	非スル穴 SR 垂込み	SR 进入非通孔	2-1-1-11	105
Solder resist dripped in plated through hole	スル内 SR 垂込み	SR 进入镀通孔	2-1-1-12	106
Solder resist ink drop	SR インク溜まり	SR 油墨的积聚 (聚油)	2-1-1-7	103
Solder resist left on conductor to be exposed	SR 被り	SR 爬上导线	2-3-2-1	145
Solder resist misalignment	版合せズレ	网版对位的偏移	2-1-1-1	100
Solder resist missing at a peeled foreign object	異物剥離部 SR 不付き	杂物剥落部位的 SR 不粘结	2-2-2-2	138
Solder resist missing between conductors	SR 導体間剥がれ	SR 在导线之间剥落	2-3-2-4	147
Solder resist missing by bubble	気泡介在 SR 不付き	SR 存在气泡的剥落	2-2-2-5	140
Solder resist missing on iron-base printed board due to a peeled foreign object	鉄基板異物剥離部 SR 不付き	铁基板的杂物剥离部位的 SR 剥落	2-2-2-1	137
Solder resist pinhole	SR ピンホール	SR 的针孔	2-2-2-4	139
Solder resist surface contaminated with marker pen ink	SR 面マジックインク汚れ	SR 表面的墨水玷污	2-1-2-23	120
Splash of silver paste	銀ペースト飛び	银膏的飞溅	5-2-4-	204
Splashed symbol mark ink by electrostatic charge	シンボルマークインク静電飛	静电使字符油墨飞溅	3-2-2-2	165
Spotty peeling of solder resist	SR 異物挟まり傷剥がれ	SR 夹杂杂物的剥离伤痕	2-1-2-39	128
Spread symbol mark	シンボルマークにじみ	字符渗油	3-1-1-2	153
Stain residue on gold deposit	金めっき汚れ残り	镀金层的玷污	4-2-1-8	178
Strip coat residue in hole	ストリップコート穴内残り	可剥离膜残留在孔内	7-4-3-	244
Superfluous solder resist by screen with partially peeled emulsion	印刷版乳剂剥離 SR 付着	网版的乳剂剥落并在 SR 附着	2-1-2-20	118
Symbol mark blister	シンボルマーク膨れ	字符的起泡	3-2-2-3	166
Symbol mark defects	シンボルマーク欠陥	字符的缺陷	3-	153
Symbol mark ink filled hole	シンボルマークインク垂込	字符油墨的垂入	3-2-2-1	164
Symbol mark over edge board contact	シンボルマーク端子部被り	字符爬上插脚	3-1-1-6	156
T				
Tacky preflux (OSP)	ブリフラックス (OSP) ベタ付き	预助焊剂 (OSP) 发粘	7-2-2-	238
Tailed nick by a foreign object	異形裾残り欠け	锯齿状的缺口	1-2-1-4	36
Tape left on solder resist surface	SR 面テープ残り	SR 表面附着胶带屑	2-1-2-22	119
Tape left under solder resist	SR 下テープ残り	SR 基底的胶带	2-1-2-29	123
Threadlike open	糸状断線	直线形状的开路	1-1-1-3	2

English	不良名	中文	コード	頁
Threadlike photo solder resist residue on edge board contact	端子部傷状 P SR 残り	插脚伤痕部の PSR	2-1-2-38	127
Too small solder coated hole	はんだめっき穴径小	热风整平时孔径变小	4-3-2-9	192
Torn off conductor	回路線剥離	线路剥落	1-9-2-	98
Trace of drilled hole on gold edge board contact	金めっき端子ドリル穴残り	镀金插脚上有多余孔	4-2-4-1	184
Transferred symbol mark	シンボルマーク転写	字符的转移	3-1-2-6	159

U

Uneven oxide treatment of innerlayer of multilayer board	多層板内層粗化处理むら	内层的粗化处理不均匀	7-4-4-	245
Uneven preflux (OSP) application	プリフラックス (OSP) 塗布むら	预助焊剂 (OSP) 涂布不均匀	7-2-1-	238
Uneven solder resist surface caused by electrostatic discharge	SR 静電気むら	SR 因静电而不均匀	2-3-2-7	148
Uneven solder thickness	はんだ厚さむら	焊料的厚度不均匀	4-3-2-4	189
Unevenly coloured symbol mark	シンボルマーク色むら	字符的颜色不均匀	3-1-1-4	155
Un-penetrated hole by broken drill bit	ドリル折れ穴未貫通	钻嘴折断且未钻透	6-4-4-	228

V

V groove misalignment between front and back sides	表裏 V カット溝ズレ	上下 V 形槽不一致	6-2-1-	214
V-grooving defect	V カット加工欠陥	V 形槽的加工缺陷	6-2-	214
V-grooving failure	V カット溝加工漏れ	漏开 V 形槽	6-2-5-	216
Via hole clogged partially with solder resist	部分的 SR 詰り	局部堵塞 SR	2-1-1-14	107
Via hole clogged with solder resist	パイアホール SR 詰り	SR 堵塞导通孔	2-1-1-13	106
Void in laminate	基板積層ボイド	层压板有空洞	7-1-2-	235
Void in laminate	積層板中ボイド	层压板有空洞	7-3-2-	241
Void in silver-paste through hole	銀スルーホールボイド	银通孔的空洞	5-2-10-	207

W X

Weed-like deposit of copper	藻巻込み銅めっき	镀铜层卷入藻类	4-1-1-4	169
Whisker	ウィスカ	晶须	1-5-1-12	62
Whitened solder resist by insufficient ink filling	SR 充填不足白化	SR 的填充不足晕圈	2-3-2-13	152
Wicking	ウィッキング	灯芯	5-1-2-9	201
Wire bonding failure	ワイヤボンディング不可	妨碍金属丝接合	7-4-7-	246
Wrinkled FPC	FPC 皺	FPC 起皱	7-4-31-	259
Wrinkled laminate copper foil	積層板銅箔部皺	层压板的铜箔起皱	7-4-23-	255
Wrong board direction relative to reinforcement fabric orientation	板目不良	板纹不对	7-4-6-	246
Wrong chamfer angle	面取り角度不良	倒角的角度欠佳	6-4-7-	229
Wrong chamfer angle	面取り幅不良	倒角的宽度不足	6-4-8-	230
Wrong coloured symbol mark	シンボルマーク色違い	字符的颜色差错	3-1-2-5	158
Wrong hole position	穴加工位置違い	孔位的错误	6-3-2-5	224
Wrong hole size	穴径違い	孔径的错误	6-3-2-2	222
Wrong machining length	加工長さ違い	加工长度的错误	6-3-2-3	223
Wrong number of holes	穴数違い	孔数量的错误	6-3-2-4	223
Wrong preflux (OSP)	プリフラックス (OSP) 違い	预助焊剂 (OSP) 的差错	7-2-4-	239

English	不良名	中文	コード	頁
Wrong slit or slot width	溝幅違い	槽宽的错误	6-3-2-1	222
Wrong solder resist ink	SR インク違い	误用 SR 油墨	2-1-1-6	103
Wrong type of gold plating	金めっき違い	镀金层的不相同	4-2-2-3	180
"X" mark on the base material under solder resist	SR 下地×印残り	SR 基底有 X 标记	2-1-2-30	123